



【1330～2400万円】 【SPE】 先端半導体製造装置 研究開発マネジャー

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズでの募集です。 商品企画・...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ

Job ID

1493940

Industry

Machinery

Job Type

Permanent Full-time

Location

Shiga Prefecture

Salary

13 million yen ~ 20 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:00

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます ※年間有給休暇は、入社月より支給（初年度は入社月により2日 23日）
未消化分は...

Refreshed

November 21st, 2024 01:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2250200】

■職務の概要

先端R&D強化を目的として新設する、少数精鋭で構成される基礎研究・開発グループのマネジャーを担当頂き、将来の新たな製品開発に繋がる、潜在的なシーズ起点の一步先の要素技術開発に携わって頂きます。

■組織のミッション

新設の基礎研究・開発グループは、当社の全製品群を対象とした基礎研究・開発を担い、潜在的な先端シーズ技術の発掘や、イノベティブなオンリーワン技術の創出等をミッションとしています

■業務内容の詳細

- 1) 少数精鋭の基礎研究・開発グループのマネージャーとして、メンバーの確保含む体制の構築
 - 2) 企画から要素開発までを、社内の関係部門、及び社外の関連機関（大学、コンソーシアム、各企業）と協力、共同して行う
 - 3) 業界動向・先端技術ロードマップの追従は勿論、これまでにない新たな技術を開発、異なる業界技術の融合による新規価値創出も視野に入れた、中・長期的な製品開発を担当、牽引
- 具体的には下記等
- ・先端シース技術や異業種の先端技術を取り込んだ、次世代の装置要素技術の開発
 - ・反りウエハ、張り合わせ、様々な厚みのウエハなど、想定される多種多様なウエハを高速、正確、且つ安定して対応可能な搬送システムの開発
 - ・ウエハ搬送に起因したパーティクル課題に対応した従来にない搬送システムの開発
 - ・装置の状態を解析し、人の介在なしに、装置内のある部位の清掃などについて、最適なタイミングを自動的に判断、実行する自動処理システムの開発

Required Skills**【職種/業界経験】**

以下業界またはアカデミックでのメカ設計、ソフト開発、要素技術開発のいずれかの経験（10年以上）。

- ・重工業（産業用ロボット）
- ・電気機器（産業用ロボット）
- ・自動車（生産技術、ロボット開発、自動運転）
- ・航空（自動運転）
- ・倉庫、運輸関連業（物流）
- ・半導体（工場、全自動化、稼働率向上など）

【求める経験・能力・スキル】

将来の装置像と必要な要素技術を立案出来る企画力、開発マネジメント経験。機械設計（搬送システム等）、ソフト開発。研究開発リーダーの経験（部長）。

※昇格においてはTOEICの社内規定があります

【歓迎条件】

グローバルな外部連携の経験、生産の視点から装置に必要な要件を理解できる。

Company Description

半導体製造装置の製造・販売